

財務概況

このセクション(財務概況)における業績は、2007年3月期の数値を示しており、比較は、2006年3月期と行っています。
なお、当社は次の会計方針及び事業区分の変更を行っています。

- 2005年3月期より、半導体製造装置及びFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から、原則として設置完了基準に変更いたしました。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法に比べ、売上高は80,956百万円、営業利益は20,541百万円、税金等調整前当期純利益は20,563百万円減少しております。
- 2005年3月期より、半導体製造装置及びFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用については、従来は支出時の費用処理から、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法に比べ、営業利益は635百万円、税金等調整前当期純利益は13,106百万円減少しております。
- 当社は、2006年10月1日付けにて、コンピュータ・ネットワーク部門を東京エレクトロニクス株式会社に株式分割により移管しました。これに伴い、「産業用電子機器」セグメントに属していた「コンピュータ・ネットワーク」事業を、2007年3月期より「電子部品・情報通信機器」(旧「電子部品事業」)セグメントに区分変更しました。

損益状況

事業環境

当連結会計年度の世界経済動向を概観すると、米国経済は年度後半における住宅市況の減速があったものの、個人消費や設備投資が堅調に推移しました。アジア経済については、中国が好調な輸出や設備投資を背景とする高い成長率を継続し、韓国や台湾も順調でした。また、日本経済は好業績企業を中心とした積極的な設備投資や輸出の増加などによって、景気回復が継続しました。

当グループの参画するエレクトロニクス産業においては、薄型大画面テレビなどのデジタル家電の需要拡大、携帯電話・パソコンの新興国への普及・拡大など好調に推移しました。こうした動向を背景に、半導体メーカーや液晶パネルメーカーが積極的な設備投資を行いました。

	2003	2004	2005	2006	(百万円) 2007
売上高	¥460,580	¥529,654	¥635,710	¥673,686	¥851,975
売上総利益	134,040	140,155	175,913	189,732	272,649
売上総利益率	29.1%	26.5%	27.7%	28.2%	32.0%
販売費及び一般管理費	132,921	117,875	111,930	114,029	128,670
営業利益	1,119	22,280	63,983	75,703	143,979
営業利益率	0.2%	4.2%	10.1%	11.2%	16.9%
税金等調整前当期純利益(損失)	(23,010)	14,936	55,775	75,328	144,414
当期純利益(損失)	(41,554)	8,297	61,601	48,006	91,263

2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは当セクションの冒頭にある記載をご参照ください。

売上の状況

2007年3月期の連結売上高は、主力事業である半導体製造装置とFPD製造装置の売上が大幅に伸長し、前期比26.5%増の8,520億円となり、過去最高を更新しました。

地域別で見ると、半導体製造装置の売上高が日本・韓国・台湾において前期を大きく上回り、それ以外の地域においても堅調に推移しました。またFPD製造装置では、日本・台湾地域での売上が引き続き好調でした。この結果、国内売上高が19.5%増加の3,138億円、海外売上高が30.9%増加の5,382億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は、前期の61.0%から63.2%に増加しました。

また、2007年3月期の連結受注高は35.4%増加の9,772億円、期末の受注残高は34.7%増加の4,863億円となり、いずれも過去最高となりました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比19.7%増加の5,793億円、売上総利益は43.7%増加の2,726億円となり、売上総利益率は3.8ポイント改善して32.0%となりました。改善の主な要因は、新製品投入による売価向上、無償保証等の追加費用の低減、生産の効率化による原価低減等です。

販売費及び一般管理費は、12.8%増加の1,287億円、売上高に対する比率は前期の17.0%から15.1%に低下しました。一般管理費に含まれる研究開発費が前期より78億円増加して570億円になったことが主たる増加の要因です。

これらの結果、営業利益は90.2%増加の1,440億円、営業利益率は5.7ポイント上昇し、16.9%となり、営業利益額、営業利益率ともこれまでの最高となりました。

研究開発費

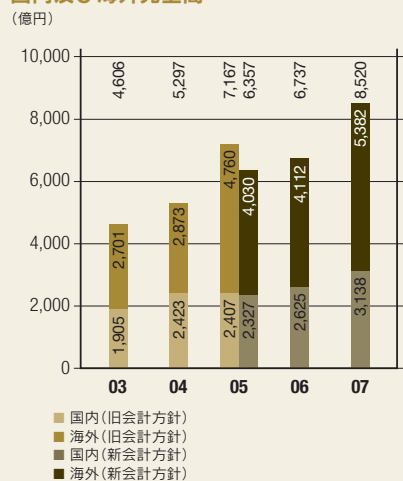
当期の研究開発には、上述のように、前期比15.8%増加の570億円を投じました。

製品別に見ると、半導体製造装置では、半導体デバイスの微細化への対応のみならず、さらなる高速化、低消費電力化を実現するための新材料への対応が求められており、これらに応える新技術・新製品の開発に取り組みました。当期は、こうした継続的な研究開発の成果として、半導体製造装置全6製品分野の全てにおいて新製品を市場にリリースすることができました。FPD製造装置では、主に、大型ガラス基板対応の装置開発に引き続き取り組みました。

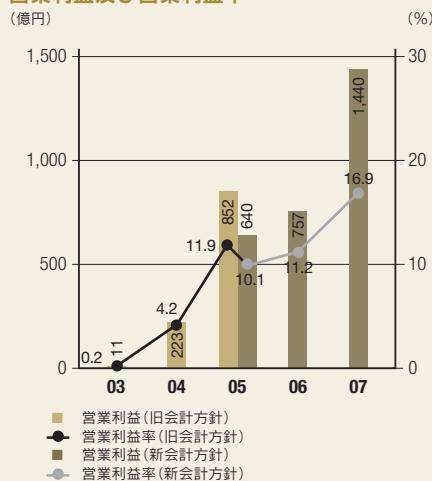
また、各製造装置の環境特性にあわせた環境負荷低減への取り組みも積極的に行っており、研究開発費の一部が使われています。

こうした既存分野における新技術・新製品の開発のみならず、優れた特性を持ったRLSAプラズマソースの装置への応用、MEMS関連装置開発など、コア技術をベースにした新規事業創出のための開発投資も行いました。

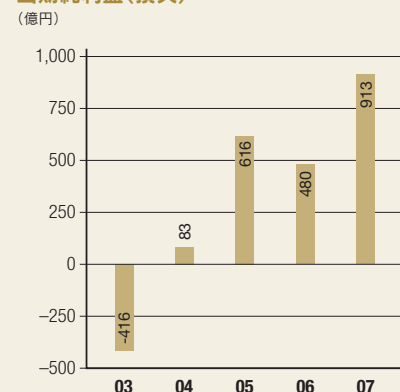
国内及び海外売上高



営業利益及び営業利益率



当期純利益(損失)



その他収益(費用)及び当期純利益

当期は、前期と同様、大きな特別利益及び特別損失が発生せず、前期その他の費用純額4億円に対し、当期のその他の収益純額は4億円となりました。この結果、税金等調整前当期純利益は、91.7%増加の1,444億円となりました。

当期純利益は前期比90.1%増の913億円となり、これまでの最高を更新しました。1株当たり当期純利益は、前期の267.61円から511.27円となりました。

配当政策及び当期配当金

当社は、業績連動型・収益対応型の配当を行うことを株主還元の基本方針としています。前期より、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途とすることを新しい配当政策とし、配当を実施しています。当期の1株当たりの配当金は前期比48円増加の103円、配当性向は連結ベースで20.1%となりました。

セグメント別の状況

産業用電子機器事業

当セグメントの2007年3月期における売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は、前期比30.7%増加の7,469億円となりました。営業利益は96.2%増加の1,404億円、営業利益率は6.3ポイント上昇し、18.8%となりました。

半導体製造装置

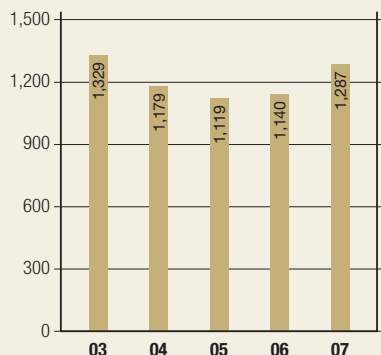
当事業の2007年3月期の外部顧客への売上高は、32.0%増加の6,426億円となりました。

デジタル家電の普及、携帯電話・パソコンの世界的な需要拡大などを背景に、これらの電子機器に搭載されるDRAM、フラッシュメモリ等の半導体メモリ需要が好調に推移しました。またパソコンの新OS「Windows Vista™」の発売やデジタル家電・モバイル機器の高機能化などに向けた半導体需要の拡大期待から、半導体メモリメーカーは設備投資を強化しました。このような環境を受け、当社製造装置に対する引き合いが活発化しました。

製品群では、アジアを中心とした半導体メモリメーカーによる力強い設備投資意欲を背景に、コータ/デベロッパ、エッチング装置、熱処理成膜装置、CVD装置、洗浄装置の売上が大きく増加しました。製品モデル別では、次世代の微細化技術に対応するコータ/デベロッパCLEAN TRACK® LITHIUS®、熱処理成膜装置の新機種TELINDY®、オートウエットステーションEXPEDIUS®、エッチングチャンバーSCCM®-JIを搭載したTelius®などの販売が拡大しました。

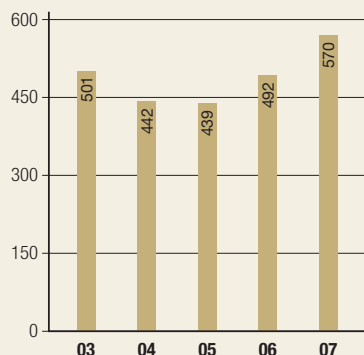
販売費及び一般管理費

(億円)



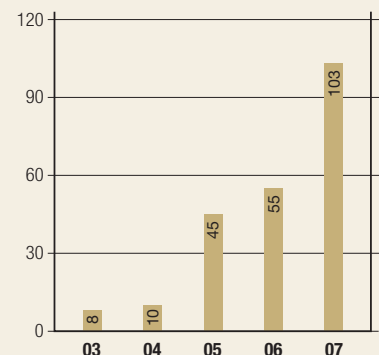
研究開発費

(億円)



1株当たり配当金

(円)



ウェーハ口径別では、300mmウェーハ対応装置売上が89%、200mmウェーハ対応装置売上が11%となりました。当事業の通期受注高は60.1%増加の8,004億円、期末の受注残高は63.3%増加の4,070億円となりました。

FPD製造装置

当事業の2007年3月期の外部顧客への売上高は、24.1%増加の1,008億円となりました。

液晶テレビなどを始めとする薄型テレビは、デジタル放送、ハイビジョン放送への移行と低価格化を背景に急速に普及・拡大してきており、日本を含むアジアの液晶パネルメーカーは、最先端の高機能・大画面ディスプレイパネルの開発と供給力強化のための設備投資を実施しました。このような環境のもと、当部門では第8世代大型ガラス基板対応の新型装置として、ドライエッチング装置「Impressio®」に続き、塗布現像装置「Exceliner®」を市場投入するなど、市場動向・市場ニーズに合致した製品開発及び販売活動に取り組みました。

売上が好調に推移する一方で、期の後半から液晶パネルの需給バランスが悪化し、受注は減少に向かいました。当事業の通期受注高は、41.0%減少の669億円、期末の受注残高は、34.2%減少の652億円となりました。

その他

その他の売上は、主に、保険業務、旅行業務等の内部サービス関連業務の売上です。売上高は、10.3%減少の11億円となりました。

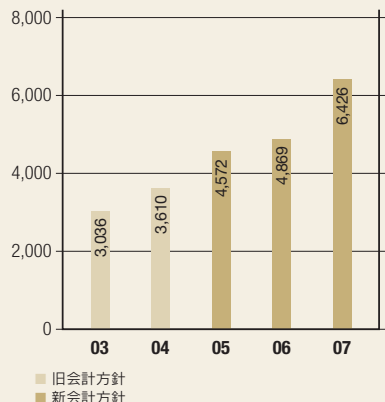
電子部品・情報通信機器事業(東京エレクトロンデバイス株式会社)

当セグメントの2007年3月期における売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は1,087億円でした。営業利益は5.1%減少の40億円、営業利益率は0.3ポイント低下し、3.7%となりました。

なお当社は、2006年10月1日付けにて、コンピュータ・ネットワーク部門を東京エレクトロンデバイス株式会社に株式分割により移管しました。これに伴い、「産業用電子機器」セグメントに属していた「コンピュータ・ネットワーク」事業を、2007年3月期より「電子部品・情報通信機器」(旧「電子部品事業」)セグメントに区分変更しました。

半導体製造装置売上高

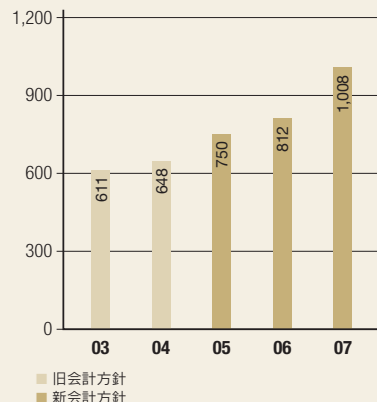
(億円)



注記: 1. 2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門の売上高から分離して開示しています。本グラフ上の2004年3月期以前の半導体製造装置売上高は、読者の利便性を考慮し、単独ベースでのFPD製造装置売上を差し引いた数字で示しています。(数字: 監査対象外)
2. 2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは当セクションの冒頭にある記載をご参照下さい。

FPD製造装置売上高

(億円)



注記: 1. 2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門の売上高から分離して開示しています。本グラフ上の2004年3月期以前のFPD製造装置売上は単独ベース、2005年3月期より連結ベースで示しています。
2. 2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは当セクションの冒頭にある記載をご参照下さい。

■ 電子部品

当事業の2007年3月期の外部顧客への売上高は、前期比1.6%増加の883億円となりました。国内におきましては、産業機器分野を重点戦略マーケットとして位置付け、カスタムICや汎用IC(アナログIC)など、高度な技術サポートを要する高付加価値商品の販売に努め、また、開発ビジネスは、設計受託業務の受注拡大、産業機器向け商品の開発に注力し、自社ブランド「インレピアム」商品の販売拡大に努めました。海外におきましては、連結子会社であるTokyo Electron Device Hong Kong Limitedがシンガポールに拠点を開設し、海外に生産拠点を展開する日系顧客のサポート充実に努めました。

■ コンピュータ・ネットワーク

当事業の外部顧客への売上高は、9.6%増加の192億円となりました。

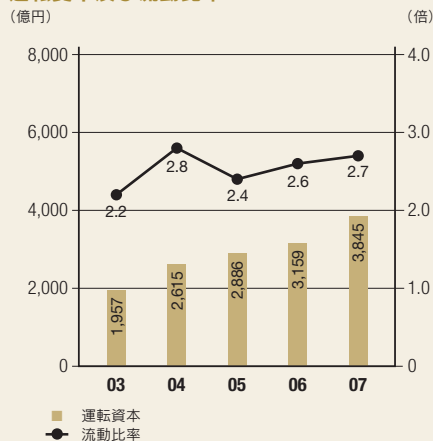
企業の内部統制やセキュリティに対する意識が向上する中、設備投資意欲も旺盛であったことからネットワーク機器及びストレージ機器の販売が増加しました。

なお、コンピュータ・ネットワーク事業は電子部品事業と共通した顧客を持ち、ともに海外のサプライヤーを中心とした最先端商品を取り扱う商社ビジネスを展開していることから、商社ビジネス上のシナジー効果、ビジネス規模拡大、それによる業績向上を図るため、東京エレクトロデバイス株式会社に移管されました。

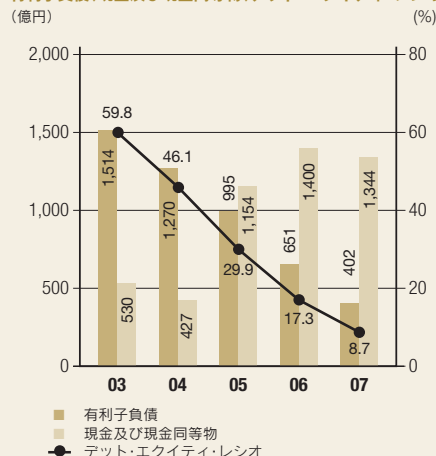
セグメント情報

	百万円				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
2007:					
売上高及び営業利益					
売上高					
外部顧客に対する売上高	¥744,512	¥107,463	¥851,975	¥ -	¥851,975
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,382	1,247	3,629	(3,629)	-
合計	746,894	108,710	855,604	(3,629)	851,975
営業費用	606,540	104,740	711,280	(3,283)	707,996
営業利益	140,354	3,970	144,324	(346)	143,979
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	¥728,236	¥ 46,730	¥774,966	¥(4,452)	¥770,514
減価償却費	20,061	360	20,421	-	20,421
資本的支出(無形固定資産及びその他資産への支出を含む)	34,795	274	35,069	-	35,069

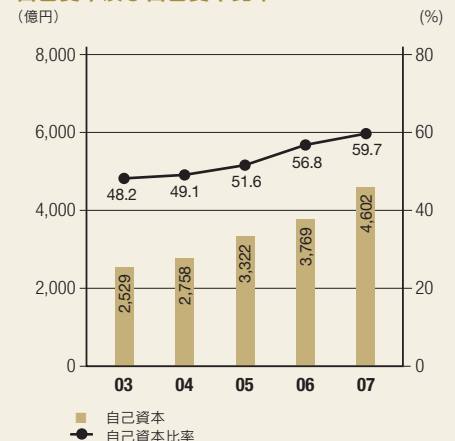
運転資本及び流動比率



有利子負債、現金及び現金同等物、デット・エクイティ・レシオ



自己資本及び自己資本比率



財政状態及びキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

当期末の総資産は、前期末から1,073億円増加の7,705億円となりました。

流動資産は、前期比929億円増加の6,104億円となりました。売上増による受取手形及び売掛金の増加597億円、ならびに下期受注増によるたな卸資産の増加311億円などによるものです。

有形固定資産は、主に建物・土地の取得により、102億円増加の1,049億円となりました。

投資その他資産は、主に米国Epion Corporation買収(買収コスト約45億円)により無形固定資産が増加し、全体では42億円増加の552億円となりました。

総負債は、201億円増加し、3,007億円となりました。

受注増による仕入の増加で支払手形及び買掛金が210億円増加し、968億円に、また課税所得増加で未払法人税等が228億円増加し、457億円になりました。また短期借入金、1年以内償還予定社債、長期借入金及び社債を合わせた有利子負債が、普通社債200億円、新株引受権付社債45億円の合計245億円の償還により、402億円となりました。これにより、デット・エクイティ・レシオ(有利子負債/自己資本比率)は前期末の17.3%から8.7%に改善しました。

純資産は、好業績の結果、利益剰余金が前期末比781億円増加したことを主な要因に、872億円増加の4,698億円となりました。これにより、自己資本比率は2.9ポイント増加の59.7%、自己資本当期純利益率(ROE)は8.3ポイント増加の21.8%となりました。

設備投資額^{*1}及び減価償却費^{*2}

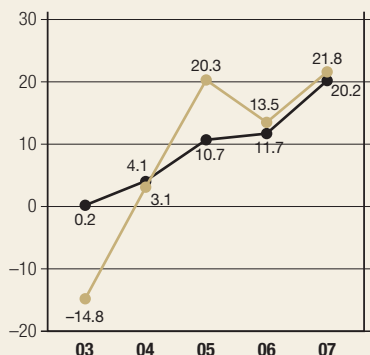
当期の設備投資額は、前期比103.4%増加の271億円となりました。設備投資の主な内容は、宮城県仙台市の研究開発拠点用土地・建物の購入、宮城県松島工場の生産スペース拡張、韓国子会社の新社屋竣工、また研究開発強化のための機械設備の取得等でした。減価償却費は、1.8%減少の188億円でした。

*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。

*2 減価償却費にはのれんの減価償却費は含まれておりません。

ROE及びROA

(%)



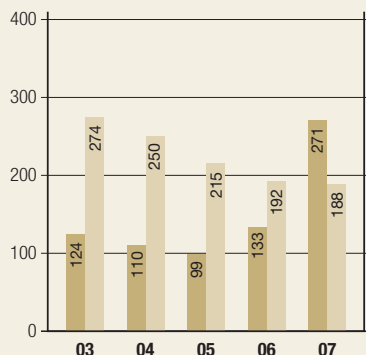
■ ROE

● ROA

ROA = (営業利益 + 受取利息及び受取配当金) / 期首・期末平均総資産 × 100

設備投資額及び減価償却費

(億円)

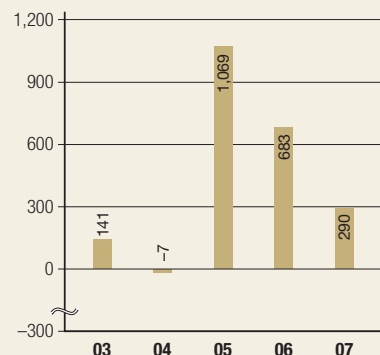


■ 設備投資額

■ 減価償却費

フリー・キャッシュ・フロー

(億円)



フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー

営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期比246億円減少の543億円となりました。主な内容としては、税金等調整前当期純利益1,444億円、減価償却費188億円、支払手形及び買掛金の増加172億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなった一方、受取手形及び売掛金の増加584億円、たな卸資産の増加316億円、前受金の減少125億円、及び法人税等の支払額378億円がキャッシュ・フローのマイナスとなったことによるものです。

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、設備投資等により前期比148億円増加の253億円となりました。将来の成長に向けた土地・建物・機械装置などの有形固定資産の取得に252億円費やすとともに、米国Epion Corporation.の買収に45億円を投じました。また当社が保有していた東証2部上場の子会社東京エレクトロンデバイス株式会社の株式の一部を、流動性を向上させる目的で売出し、売却額として42億円の収入がありました。

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前期比87億円増加の347億円となりました。主な内容は、第10回無担保社債200億円の償還、第4回無担保新株引受権付社債45億円の償還、配当金の支払い128億円です。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、56億円減少の1,344億円となりました。

事業などのリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっています。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としていますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約などによって為替リスクヘッジに努めています。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術などの最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれなどの影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置などのハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加などの発生により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理などの各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しています。しかしながら、当社製品に関連する安全性などの問題により、顧客への損害発生、受注取消などが発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用して頂くことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品であるなどの原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生するなどにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や知的財産権を回避する場合などがあるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症などの不可抗力、金融・株式市場、政府などによる規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失などの影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。